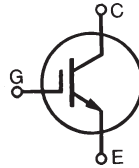


# HiPerFAST™ IGBT

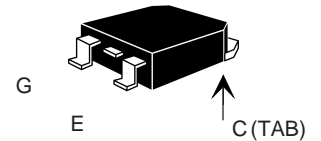
**IXGH 15N120B**  
**IXGT 15N120B**

**$V_{CES} = 1200 \text{ V}$**   
 **$I_{C25} = 30 \text{ A}$**   
 **$V_{CE(sat)} = 3.2 \text{ V}$**   
 **$t_{fi(typ)} = 160 \text{ ns}$**

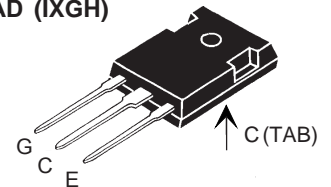


Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
$V_{CES}$	$T_J = 25^\circ\text{C to } 150^\circ\text{C}$	1200	V
$V_{CGR}$	$T_J = 25^\circ\text{C to } 150^\circ\text{C}; R_{GE} = 1 \text{ M}\Omega$	1200	V
$V_{GES}$	Continuous	$\pm 20$	V
$V_{GEM}$	Transient	$\pm 30$	V
$I_{C25}$	$T_C = 25^\circ\text{C}$	30	A
$I_{C110}$	$T_C = 110^\circ\text{C}$	15	A
$I_{CM}$	$T_C = 25^\circ\text{C}, 1 \text{ ms}$	60	A
<b>SSOA (RBSOA)</b>	$V_{GE} = 15 \text{ V}, T_{VJ} = 125^\circ\text{C}, R_G = 10 \Omega$ Clamped inductive load	$I_{CM} = 40$ @ $0.8 V_{CES}$	A
$P_C$	$T_C = 25^\circ\text{C}$	180	W
$T_J$		-55 ... +150	$^\circ\text{C}$
$T_{JM}$		150	$^\circ\text{C}$
$T_{stg}$		-55 ... +150	$^\circ\text{C}$
Maximum Lead temperature for soldering		300	$^\circ\text{C}$
1.6 mm (0.062 in.) from case for 10 s			
Maximum Tab temperature for soldering SMD devices for 10 s		260	$^\circ\text{C}$
$M_d$	Mounting torque (M3)	1.13/10Nm/lb.in.	
<b>Weight</b>	TO-247 AD	6	g
	TO-268	4	g

**TO-268 (IXGT)**



**TO-247 AD (IXGH)**



G = Gate, C = Collector,  
E = Emitter, TAB = Collector

## Features

- International standard packages JEDEC TO-268 surface and JEDEC TO-247 AD
- Low switching losses, low  $V_{(sat)}$
- MOS Gate turn-on - drive simplicity

## Applications

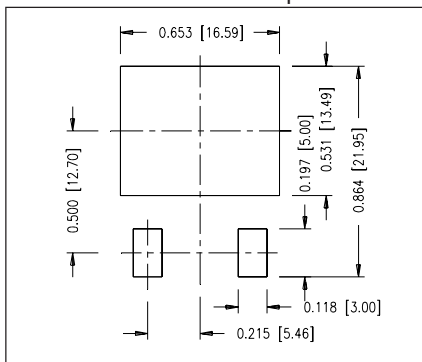
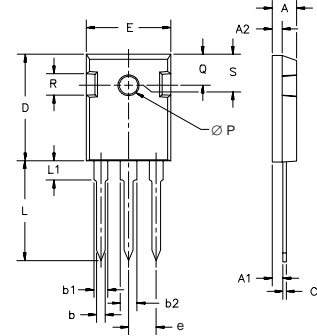
- AC motor speed control
- DC servo and robot drives
- DC choppers
- Uninterruptible power supplies (UPS)
- Switched-mode and resonant-mode power supplies

## Advantages

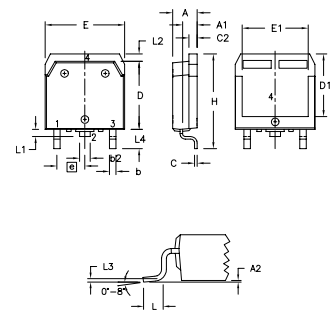
- High power density
- Suitable for surface mounting
- Easy to mount with 1 screw, (isolated mounting screw hole)

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values ( $T_J = 25^\circ\text{C}$ , unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
$BV_{CES}$	$I_C = 250 \mu\text{A}, V_{GE} = 0 \text{ V}$	1200		V
$V_{GE(th)}$	$I_C = 250 \mu\text{A}, V_{CE} = V_{GE}$	2.5		V
$I_{CES}$	$V_{CE} = V_{CES}$ $V_{GE} = 0 \text{ V}$	$T_J = 25^\circ\text{C}$		100 $\mu\text{A}$
		$T_J = 125^\circ\text{C}$		3.5 mA
$I_{GES}$	$V_{CE} = 0 \text{ V}, V_{GE} = \pm 20 \text{ V}$			$\pm 100 \text{ nA}$
$V_{CE(sat)}$	$I_C = I_{C90}, V_{GE} = 15 \text{ V}$		2.5	3.2 V
	$T_J = 125^\circ\text{C}$			V

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values ( $T_J = 25^\circ\text{C}$ , unless otherwise specified)			
		min.	typ.	max.	
$g_{fs}$	$I_C = I_{C110}$ ; $V_{CE} = 10\text{ V}$ , Pulse test, $t \leq 300\ \mu\text{s}$ , duty cycle $\leq 2\%$	12	15	S	
$C_{ies}$	$V_{CE} = 25\text{ V}$ , $V_{GE} = 0\text{ V}$ , $f = 1\text{ MHz}$		1720	pF	
$C_{oes}$			95	pF	
$C_{res}$			35	pF	
$Q_g$	$I_C = I_{C110}$ , $V_{GE} = 15\text{ V}$ , $V_{CE} = 0.5 V_{CES}$		69	nC	
$Q_{ge}$			13	nC	
$Q_{gc}$			26	nC	
$t_{d(on)}$	<b>Inductive load, <math>T_J = 25^\circ\text{C}</math></b> $I_C = I_{C110}$ , $V_{GE} = 15\text{ V}$ $V_{CE} = 0.8 V_{CES}$ , $R_G = R_{off} = 10\ \Omega$ Remarks: Switching times may increase for $V_{CE}$ (Clamp) $> 0.8 \cdot V_{CES}$ , higher $T_J$ or increased $R_G$		25	ns	
$t_{ri}$			15	ns	
$t_{d(off)}$			180	280	ns
$t_{fi}$			160	320	ns
$E_{off}$			1.75	3.0	mJ
$t_{d(on)}$	<b>Inductive load, <math>T_J = 125^\circ\text{C}</math></b> $I_C = I_{C110}$ , $V_{GE} = 15\text{ V}$ $V_{CE} = 0.8 V_{CES}$ , $R_G = R_{off} = 10\ \Omega$ Remarks: Switching times may increase for $V_{CE}$ (Clamp) $> 0.8 \cdot V_{CES}$ , higher $T_J$ or increased $R_G$		25	ns	
$t_{ri}$			18	ns	
$E_{on}$			0.60		mJ
$t_{d(off)}$			300		ns
$t_{fi}$			360		ns
$E_{off}$		3.5		mJ	
$R_{thJC}$				0.65 K/W	
$R_{thCK}$	(TO-247)		0.25	K/W	

**Min Recommended Footprint**

**TO-247 AD Outline**


Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	4.7	5.3	.185	.209
A <sub>1</sub>	2.2	2.54	.087	.102
A <sub>2</sub>	2.2	2.6	.059	.098
b	1.0	1.4	.040	.055
b <sub>1</sub>	1.65	2.13	.065	.084
b <sub>2</sub>	2.87	3.12	.113	.123
C	.4	.8	.016	.031
D	20.80	21.46	.819	.845
E	15.75	16.26	.610	.640
e	5.20	5.72	0.205	0.225
L	19.81	20.32	.780	.800
L1		4.50		.177
∅P	3.55	3.65	.140	.144
Q	5.89	6.40	0.232	0.252
R	4.32	5.49	.170	.216
S	6.15	BSC	242	BSC

**TO-268 Outline**


Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	4.9	5.1	.193	.201
A <sub>1</sub>	2.7	2.9	.106	.114
A <sub>2</sub>	.02	.25	.001	.010
b	1.15	1.45	.045	.057
b <sub>1</sub>	1.9	2.1	.75	.83
C	.4	.65	.016	.026
D	13.80	14.00	.543	.551
E	15.85	16.05	.624	.632
E <sub>1</sub>	13.3	13.6	.524	.535
e	5.45	BSC	.215	BSC
H	18.70	19.10	.736	.752
L	2.40	2.70	.094	.106
L1	1.20	1.40	.047	.055
L2	1.00	1.15	.039	.045
L3		0.25		.010 BSC
L4	3.80	4.10	.150	.161

IXYS reserves the right to change limits, test conditions, and dimensions.

IXYS MOSFETs and IGBTs are covered by one or more of the following U.S. patents:

4,835,592	4,881,106	5,017,508	5,049,961	5,187,117	5,486,715	6,306,728B1
4,850,072	4,931,844	5,034,796	5,063,307	5,237,481	5,381,025	

Fig. 1. Saturation Voltage Characteristics @ 25°C

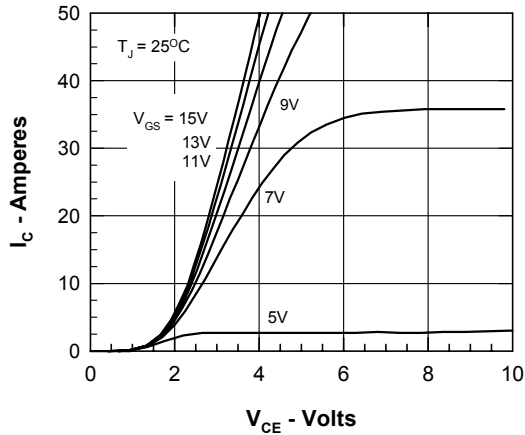


Fig. 2. Extended Output Characteristics

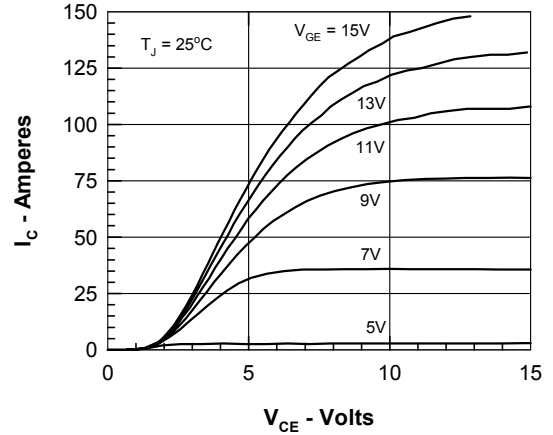


Fig. 3. Saturation Voltage Characteristics @ 125°C

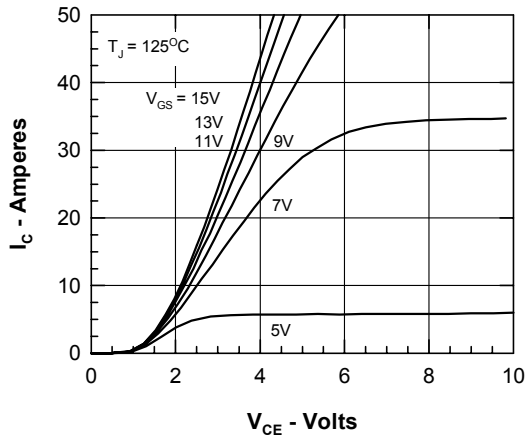


Fig. 4. Temperature Dependence of  $V_{CE(SAT)}$

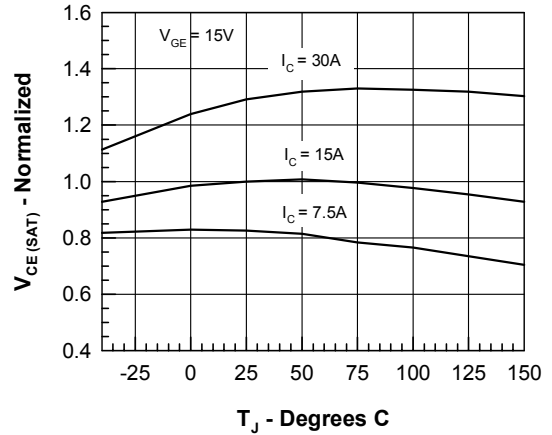


Fig. 5. Admittance Curves

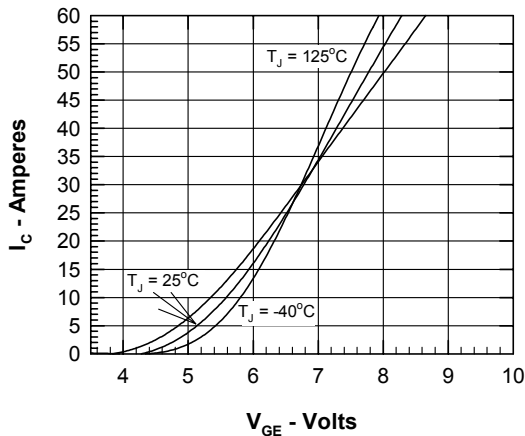


Fig. 6. Capacitance Curves

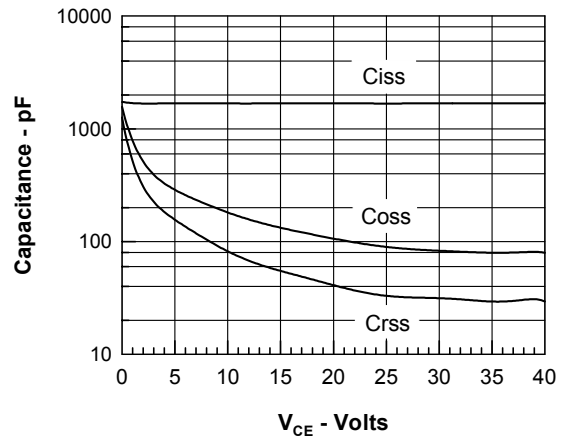


Fig. 7. Dependence of  $E_{OFF}$  on  $I_C$ .

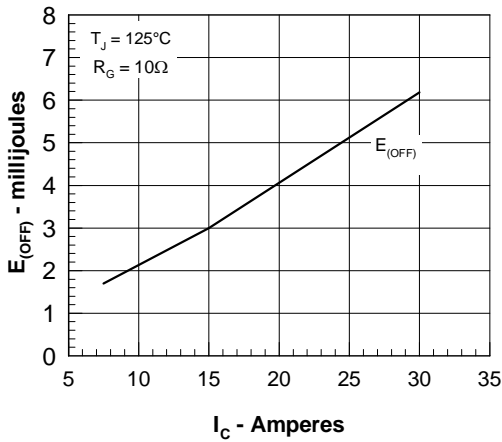


Fig. 8. Dependence of  $E_{OFF}$  on  $R_G$ .

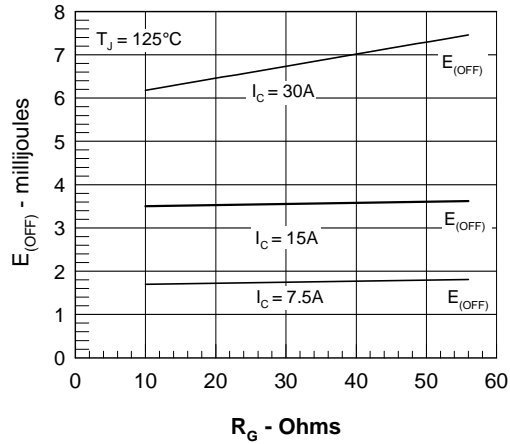


Fig. 9. Gate Charge

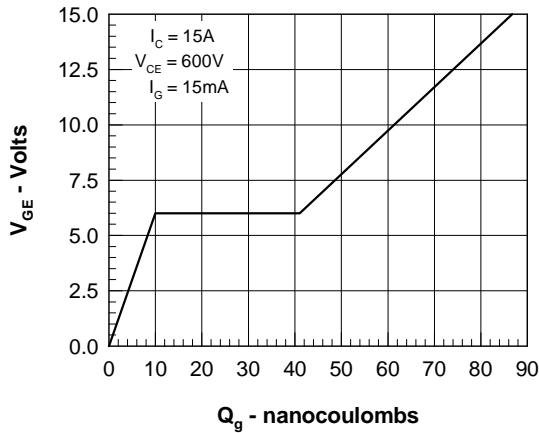


Fig. 10. Turn-off Safe Operating Area

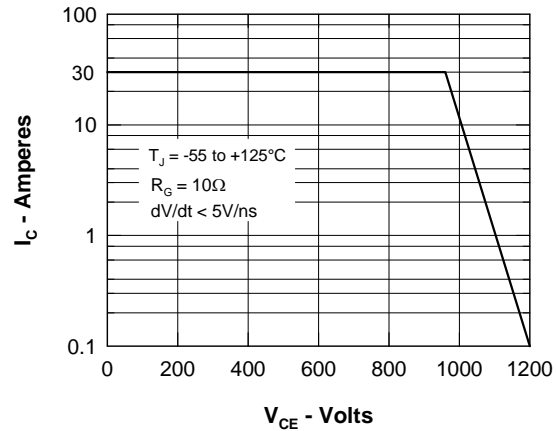
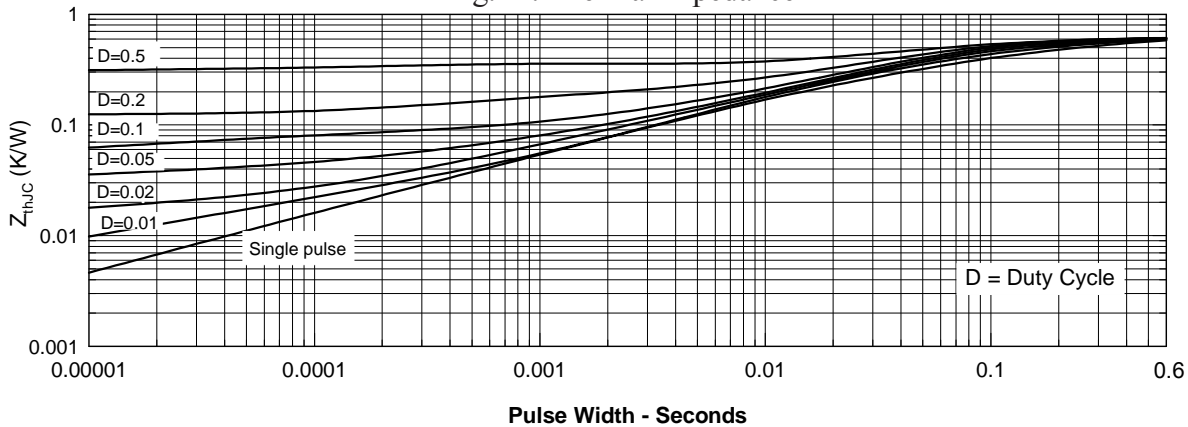


Fig. 11. Thermal Impedance





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.